



### שבב תלת ממדי של יבמ

תעשיית השבבים מתכוננת לדבר הבא - שבבים תלת ממדיים, כנראה שלא תהיה ברירה וזו הדרך היחידה להגדיל ביצועים ולהפחית צריכת השמל?

זו עשויה להיות גלובל פאונדריו שתחתוך מחירים מול יריבתה TSMC לתהליך עיבוד של 2.5 ממדים (אם תצליח לספק אותו) או סמסונג שעשויה להרחיב את הפער שלה מול אפל בטלפונים חכמים וטבלטים או אולי NVIDIA שתנסה באמצעות שיפור טכנולוגי זה לנגוס בשוק ה-GPU מול AMD.

הערכות אלו הועלו בפאנל שעסק בגילוי המפתיע של אפל כי שבב A7 שבליבת מכשירי האייפון 5s הוא תלת מימד לעניינם. באותו פאנל הציגו אנשי זיילינקס כי הם כבר מספקים שבבי 2.5 מימדים כאשר ה-die שוכנים זה לצד זה על מפריד מסיליקון. עד כה הוא משמש בעיקר למוצרי FPGA. ספקית ה-FPGA תציג את מוצריה בועידה הבינלאומית למעגלי מצב מוצק שתתקיים בפברואר, בדמות שני שבבי 65 ננומטר. היא גם מסרה כי בפיתוח נמצאים גם ADC ו-DAC ל-FPGA לשימוש בתחנות בסיס סלולריות, כדי להפחית את עלות הייצור ואת צריכת האנרגיה. כעת היא מתחילה בייצור בנפחים קטנים.

{loadposition content-related}